

● WLP-6-05パッケージ許容損失

WLP-6-05パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pbフリーはんだ

実装基板: 銅箔4層基板40mm×40mm(片面1600mm²)
に対して銅箔面積

1層目: 約50%_各リード接続

2層目: 約50%_各リード接続

3層目: 約50%_各リード接続

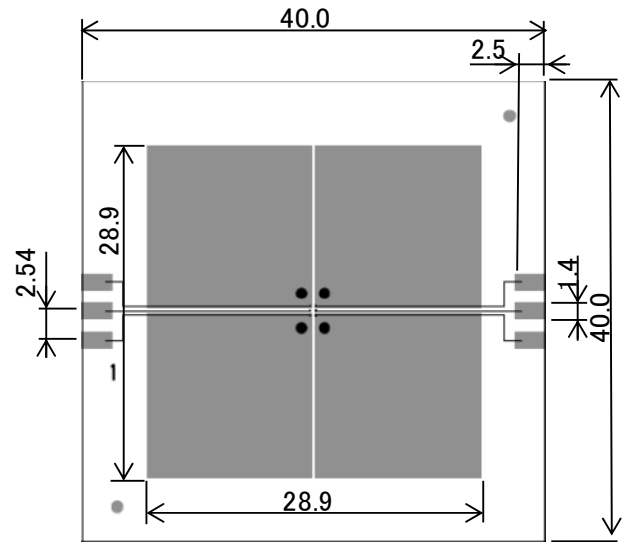
4層目: 約50%_各リード接続

基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: ホール径 0.8mm 4個

銅箔厚: 表面 35um、裏面 35um



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失 - 周囲温度特性

基板実装(T_{jmax} = 125°C)

| Ambient Temperature (°C) | Power Dissipation Pd (mW) | | θ _{ja} (°C/W) |
|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| | Ta max=85°C | Ta max=105°C | |
| 25 | 700 | 700 | 142.86 |
| 85 | 280 | 280 | |
| 105 | 0 | 140 | |
| 125 | 0 | 0 | |

